

**平成 30 年度 英国リーズ大学短期英語研修 学資援助**  
**- 2018 KIT English-in-the-UK Programme -**

**1. 趣旨**

本制度は、大学間交流協定校である英国リーズ大学で開催される英語研修に参加する本学学部学生への学資援助を行うことにより、学生の英語能力向上を図るとともに、本学の国際交流を促進することを目的とするものです。

**2. 申請資格**

- ・本学学部の日本人学生（2・3回生が望ましいが、1・4回生も可）  
（出入国管理及び難民認定法等にいう「永住者」及び「特別永住者」を含む）
- ・TOEIC550点以上（申請状況により、英語運用能力を判断するためのテストを別途行うことがあります。）
- ・学生後援会の会費を納入済みであること（納入状況が不明な場合は、学務課学務企画係まで照会ください。）

**3. 採用人数**

10名程度（申請者数等により決定）

**4. 学資援助額**

1人当たり100,000円を上限とします。

**5. 研修期間と場所**

研修期間：2018年8月5日（日）～9月9日（日）（研修は8/6～9/7の5週間）

研修場所：リーズ大学（イングランド北部にある国立大学、<http://www.leeds.ac.uk/>）

**6. 研修内容**

ホームステイをしながら、大学付属語学センターのGeneral English Programmeに参加。各自のレベルに応じたクラスに参加し、世界各国からの学生と肩をならべて、総合的な英語運用能力の向上をめざします。

**7. 必要経費**（研修費用及びホームステイ代は現時点での見積もりであり、変更の可能性があります。）

研修費用：1,350ポンド（旅行会社の支払いレート156.46円を乗じると211,221円）

ホームステイ代：817ポンド（旅行会社の支払いレート156.46円を乗じると127,828円）

往復旅費：実費（航空運賃の参考見積額234,290円） その他、保険代

\*これらの合計のうち、100,000円（上限）を大学が援助することになります。

**8. リスク管理について**

本学教職員は同行しませんが、現地語学学校のスタッフ、本学の研修担当スタッフ及び本学と提携する旅行会社が連携して、緊急事態に対応できる体制を整えます。

**9. 応募手続**

申請する学生は、学務課学務企画係（センターホール1階）または説明会の会場で、申請書類を受け取り、別紙様式1の「平成30年度 英国リーズ大学短期英語研修 学資援助申請書」を下記の申請受付期間に提出してください。

**10. 申請受付期間**

2018年4月23日（月）～5月8日（火）13:00 ご家族に相談してから申し込んでください。

**11. 選考方法等**

研修参加者は、①申請書類 ②昨年度後学期までの成績（GPA）

③TOEICスコア ④面接（英語及び日本語）を総合して決定します。

※選考結果は2018年5月21日（月）までに通知する予定です。

**12. その他**

この研修に参加し、成績・出席等において本学が定めた基準を満たした学生には、「言語教育科目（選択：海外英語研修）」として2単位が認定されます。

**13. 照会先**

京都工芸繊維大学学務課学務企画係（センターホール1階）

Tel : 075-724-7123 Fax : 075-724-7120 E-mail : [gakumu@jim.kit.ac.jp](mailto:gakumu@jim.kit.ac.jp)

\*\*\*\*\*

## 英国リーズ大学 短期英語研修 説明会のご案内

本学は、学部学生を対象とする「英国リーズ大学短期英語研修」のための学資援助を実施します。

このたび、研修プログラムの内容に関して、本学教員による説明会を開くことになりました。昨年度の研修参加者が、皆さんからの質問にも答えてくれる予定です。応募を検討している方や、興味・関心のある方は、是非、ご参加ください。

記

説明会

MANCHESTER

LEEDS

日時：平成 30 年 4 月 23 日（月）12 時 10 分～12 時 45 分

場所：東 3 号館 1 階 K101 講義室

内容：・研修内容の詳細

- ・応募手続きの詳細（選考方法、選考結果の通知方法など）
- ・昨年度の参加者の報告
- ・学生からの質問受付

LONDON

BRISTOL

\*\*\*\*\*

事務担当、照会先

京都工芸繊維大学学務課学務企画係（センターホール 1 階）

Tel：075-724-7123

Fax：075-724-7120

E-mail: [gakumu@jim.kit.ac.jp](mailto:gakumu@jim.kit.ac.jp)